

## 設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : MD-CD1MK3, ETC. 変更番号 : EA6061  
PRODUCTS E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

タイトル : 銀through基板を銅through基板に変更

TITLE  
同期設定 : - - -  
SIMULTANEOUS E. C. N.  
関連設定 : - - -  
RELATED E. C. N.

設変記事 : 銀through基板を銅through基板に変更  
CONTENTS

銀through基板を銅through基板に変更するにあたり、価格の低い業者へ  
 転注します。  
 それに伴い、基板の品番をRevision Upします。  
 ※品番のRevision Upに合わせ、基板のSilkも変更します。

【対象機種】

- ① MD-CD1MK3, MD-CD1BMK3, MD-70CD-S  
② MD-CD1BMK3, LA-MC1

**【变更内容】**

- |   |            |   |            |                      |
|---|------------|---|------------|----------------------|
| ① | E90200900F | → | E90200900G | PCB, GATHER MD-CD1 G |
| ② | E90219700C | → | E90219700D | PCB, XLR LA-MC1      |

【実施時期】

- ① 在庫(380枚)消化後、実施  
② 在庫消化後、実施

### 【旧部品処理】

- ① Baking処理済みの380枚は使用可。  
Baking未処理の62枚は廃棄。

①②基板新旧混在可

依頼者  
 檢図者  
 承認者  
 DTA購買課  
 生産技術課  
 生産技術課  
 鴫田Mgr  
 松浦部長

译：市场客诉不具合对应，故将PCB生产工艺从银浆灌孔工艺变为沉铜工艺。

**实施：**E90200900F在库380PCS消化完后使用新品；E90219700C在库消化后实施。  
E90200900F和E90219700C新旧品可混用。

旧品处理：E90200900F烘烤过的380PCS可使用，没烘烤过的62PCS废弃。

関連図面 : ---  
RELATED DRAWINGS

設変会議日 :  
DATE

担当 : 1720 michiko sato  
PERSON IN CHARGE

依頼元 : DTA購買課  
REQUESTING SECTION

設変会議 : 要 To be held  
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -  
 P. P. NO.  
 技術連絡書№ : - - -  
 ENG. INFO. NO.

**実施** : To be enforced  
**ENFORCEMENT**

変更理由 (主) : RELIABILITY  
REASON (MAIN)  
変更理由 (従) :  
REASON (SUB)

安全規格 : NOT required  
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated  
COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認	:	NOT required
CUSTOMER'S APPRV	:	
S マニュアル訂正	:	NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL	:	
取説訂正	:	NOT required
CHG. IN USR. MANUAL	:	
カタログ訂正	:	NOT required
CHG. IN BROCHURE	:	
作業標準訂正	:	NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL	:	
技術情報発行	:	NOT required
ENGINEERING INFO.	:	

コスト変動 : No change  
COST

単位コスト :  
UNIT COST :  
金型改造費 :  
COST FOR DIE :

設計変更情報 詳細情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : MD-CD1MK3, LA-MC1, MD-70CD-S  
PRODUCTS MD-CD1BMK3

変更番号 : EA6061  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

設変会議日 :  
DATE  
タイトル : 銀through基板を銅through基板に変更  
TITLE

親品目 : E90200900G PCB, GATHER MD-CD1 G MATERIAL ( 1)												
旧品目 (BEFORE CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4				
COMPONENT	DESCRIPTION			COMPONENT	DESCRIPTION			ITEM	CMP	2ND	INS	PART
1- 1				E90201000F	PCB, FRONT MD-CD1	1.000		0010	D*	3	5	5
1- 2				E90201100E	PCB, VOL KEY I/F MD-CD1	1.000		0020	D*	3	5	5
1- 3				E90201200G	PCB, PHONE MD-CD1	1.000		0030	D*	3	5	5
1- 4				E90201300C	PCB, POW SW MD-CD1	1.000		0040	D*	3	5	5
1- 5				E90201400E	PCB, 232C MD-CD1	1.000		0050	D*	3	5	5
1- 6				E90201500E	PCB, SLIDE SW MD-CD1	1.000		0060	D*	3	5	5
親品目 : E95200920A PCBA, GATHER MCD3 G MATERIAL ( 2)												
旧品目 (BEFORE CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4				
COMPONENT	DESCRIPTION			COMPONENT	DESCRIPTION			ITEM	CMP	2ND	INS	PART
2- 1	E90200900F	1.000		E90200900G	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000		0001	C*	3	5	4
親品目 : E95200954A PCBA, GATHER CHI MCD3 G MATERIAL ( 3)												
旧品目 (BEFORE CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4				
COMPONENT	DESCRIPTION			COMPONENT	DESCRIPTION			ITEM	CMP	2ND	INS	PART
3- 1	E90200900F	1.000		E90200900G	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000		0001	C*	3	5	4
親品目 : E95432400A PCBA, GATHER MCDB3 G MATERIAL ( 4)												
旧品目 (BEFORE CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE)		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4				
COMPONENT	DESCRIPTION			COMPONENT	DESCRIPTION			ITEM	CMP	2ND	INS	PART
4- 1	E90200900F	1.000		E90200900G	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000		0001	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報  
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : MD-CD1MK3, LA-MC1, MD-70CD-S  
PRODUCTS MD-CD1BMK3

変更番号 : EA6061  
E. C. N. No  
(ステータス : Fixed )  
STATUS

設変会議日 :  
DATE  
タイトル : 銀through基板を銅through基板に変更  
TITLE

親品目 : EZ5219700A PCB ASSY, S-XLR LA-MC1 MATERIAL ( 5)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
5- 1	E90219700C	PCB, XLR LA-MC1	1.000	+	E90219700D	PCB, XLR LA-MC1	1.000
親品目 : Y00537300A PCB SECT, MCD3 (G) MATERIAL ( 6)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
6- 1	E90200900F	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000	+	E90200900G	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000
親品目 : Y00538300A PCB SECT, MCB3 (G) MATERIAL ( 7)							
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT
7- 1	E90200900F	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000	+	E90200900G	PCB, GATHER MD-CD1 G	1.000
7- 2	E90219700C	PCB, XLR LA-MC1	1.000	+	E90219700D	PCB, XLR LA-MC1	1.000

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY  
1ST A 有 COMPATIBLE  
BYTE B →  
C ←  
D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER  
1 有り EXIST  
2 優先 PREFERENTIAL  
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION  
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS  
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCESS)  
3 在庫部品 STOCK  
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER  
5 新規発注 NEW ORDER  
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK  
1 転用 CONVERSION  
2 廃棄 DISPOSAL  
3 追加工 REPROCESSING  
4 消化 CONSUMPTION  
5 無し NOT NECESSARY  
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE  
BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE